

# 光学BGA返修台全自动BGA返修设备-德正智能

产品名称	光学BGA返修台全自动BGA返修设备-德正智能
公司名称	深圳市德正智能科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:德正智能 型号:DEZ-R850 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道江边第二工业区19栋
联系电话	0755-27218816 13670102286

## 产品详情

光学BGA返修台全自动BGA返修设备-德正智能

DEZ-R850型高精度光学BGA返修设备的主要特点：

触摸屏顶部触屏操作直观，简单易懂，加热温度、升温速度、冷却时间、提前报警、真空时间等全在口本机屏屏显示，并可进行精确的温度控制，独立控制芯片焊接温度曲线，四个独立测温接加热分区，独立加热每个温度，可独立设置升温速度、加热时间、冷却升温斜率；六个加热温段，模拟回流焊。本机带有自动送料、吸料、放料功能；对位时能自动识别芯片中心位置；客户可根据需求选择，有【焊接、卸下、贴装、手动】四个模式，可实现自动和半自动功能，更好的满足选用美国进口高精度K型热电偶闭环控制，加以我司采用的独特加热方式，保证焊接温差在 $\pm 1$ 。控制柜采用进口光学对位系统，配备15寸高清显示器；选用高精度千分尺进行X/Y/R轴调节；确保对位精度的多种选择，加热风速易和更换头特殊要求可定做。配有多种规格BGA加热风咀，更好的满足客户修能速到，精度高，完全避免人为作业误差；对无铅工艺和双层BGA、QFN、QFP、电容电阻等元器件返侧方监控相机，可对锡球进行锡球融化观测，方便确定曲线及焊接效果；(此功能为选配项)。

DEZ-R850 返修设备主要参数：

总功率	6800W
上部加热功率	1200W
下部加热功率	

下部红外加热功率	4200W ( 2400W受控 )
电源	单相(Single Phase) AC 220V ± 10 50Hz
定位方式	光学镜头+ V字型卡槽+激光定位灯快速定位。
温度控制	高精度K型热电偶 ( Ksensor ) 闭环控制 ( Closed Loop ) ，上下独立测温  温度精度可达正负1度；
电器选材	高灵敏触摸屏+温度控制模块 + PLC + 步进驱动器
大PCB尺寸	500 × 450mm
小PCB尺寸	10 × 10mm
测温接口数量	4个
芯片放大倍数	2-30倍
PCB厚度	0.5-8mm
适用芯片	0.3*0.6mm-80*80mm
适用芯片小间距	0.15mm
贴装大荷重	500G
贴装精度	± 0.01mm
外形尺寸	L670 × W780 × H900mm
光学对位镜头	电驱可前后左右移动，杜位死角
机器重量	净重约90kg

光学BGA返修台全自动BGA返修设备-德正智能